（上接B009）

及实际付款进度、相关资产的实际交付情况，上述供应商及其关键人员与公司及关联方是否存在关联关系、股权或任职关系、其他业务或资金往来，相关付款是否存在直接或间接流向控股股东及其关联方的情形，新增资产是否与增值税留抵税额相匹配

1、最近三年固定资产、在建工程采购前十大供应商的采购金额及占比、付款约定及实际付款进度、相关资产的实际交付情况

（1）2023年至2025年固定资产、在建工程采购前十大供应商采购金额及占比

1）2023年

单位：万元

供应商名称	采购金额	占当期固定资产、在建工程采购增加额的比重（%）
中国建筑股份有限公司	23,004.54	7.91
辛耘企业股份有限公司	13,684.03	4.70
南京晶升装备股份有限公司	13,234.16	4.56
Axcelis Technologies, Inc.（亚舍立科技公司）	10,693.97	3.68
SPTS Technologies Ltd.（思慕斯技术有限公司）	9,165.08	3.15
圣晖系统集成集团股份有限公司	8,199.76	2.82
北京北方华创微电子装备有限公司	6,219.85	2.14
中国一冶集团有限公司	5,985.73	2.06
中国电子系统技术有限公司	5,628.91	1.94
TOKYO ELECTRON LIMITED（东京电子株式会社）	5,336.20	1.83
合计	101,151.23	34.76

2）2024年

单位：万元

供应商名称	采购金额	占当期固定资产、在建工程采购增加额的比重（%）
中国建筑股份有限公司	28,231.79	6.57
Applied Materials South East Asia Pte.Ltd.（应用材料东南亚私人有限公司）	25,726.87	5.99
中国电子系统技术有限公司	21,703.93	5.05
KLA Corporation（科磊公司）	17,554.22	4.09
南京晶升装备股份有限公司	11,924.84	2.78
苏州市洋基机电工程有限公司	11,604.17	2.70
ASM International N.V.（先进半导体材料国际公共有限责任公司）	9,678.43	2.25
Centrotherm international AG（商先创国际股份有限公司）	9,147.85	2.13
Axcelis Technologies, Inc.（亚舍立科技公司）	8,701.81	2.03
TOKYO ELECTRON LIMITED（东京电子株式会社）	6,585.55	1.53
合计	150,850.46	35.12

3）2025年

单位：万元

供应商名称	采购金额	占当期固定资产、在建工程采购增加额的比重（%）
Canon INC.（佳能股份有限公司）	13,590.10	6.04
中国电子系统技术有限公司	10,037.03	4.46
深圳市标谱半导体股份有限公司	9,185.59	4.08
南昌中微半导体设备有限公司	8,920.00	3.97
ASM International N.V.（先进半导体材料国际公共有限责任公司）	8,135.62	3.62
TOKYO ELECTRON LIMITED（东京电子株式会社）	7,849.03	3.49
南京晶升装备股份有限公司	5,838.00	2.60
Siconnex customized solutions GmbH（西蒙耐思定制化解决方案有限责任公司）	5,376.04	2.39
福建省工业设备安装有限公司	4,796.63	2.13
泰远电子系统工程（上海）有限公司	4,437.73	1.97
合计	78,165.77	34.75

（3）2023年至2025年固定资产、在建工程采购前十大供应商主要采购合同、采购内容、付款约定、付款进度及资产交付情况

1）2023年

单位：万元

序号	供应商名称	采购合同金额	采购内容	采购数量	付款约定	已付款金额	实际付款进度（%）	截至目前资产实际交付情况
1	中国建筑股份有限公司	30,600.00	工程施工	/	按工程进度付款	23,923.08	78.18	工程已完工
2	辛耘企业股份有限公司	2,520.67	ICP干法刻蚀机	2	30%预付+70%LC（60%发货，10%验收）	2,375.40	94.24	设备已全部交付
3	辛耘企业股份有限公司	4,043.60	ICP锗硅刻蚀机	2	30%预付+70%LC（60%发货，10%验收）	3,775.17	93.36	设备已全部交付
4	辛耘企业股份有限公司	4,195.48	氮化硅刻蚀机3台，探针式表面检测仪2台	5	30%预付+70%LC（60%发货，10%验收）	3,060.64	72.95	设备已全部交付
5	南京晶升装备股份有限公司	7,316.98	4吋/6吋导电碳化硅生长炉HSICM2420/P40	120	发货前支付80%，验收后支付20%。	5,853.58	80.00	设备已全部交付
6	南京晶升装备股份有限公司	6,048.44	4吋/6吋导电碳化硅生长炉HSICM2420/P40	110	发货前支付80%，验收后支付20%。	4,838.75	80.00	设备已全部交付
7	Axcelis Technologies, Inc.（亚舍立科技公司）	10,693.97	离子注入机PurionM	3	60%预付+70%LC（30%发货，10%验收）	10,693.97	100.00	设备已全部交付
8	SPTS Technologies Ltd.（思慕斯技术有限公司）	6,179.79	SPTSPRECVD	2	30%预付+70%LC（60%发货，10%验收）	5,888.99	95.29	设备已全部交付
9	圣晖系统集成集团股份有限公司	6,049.50	工程施工	/	40%预付+40%进度+10%验收+10%质保	6,049.50	100.00	工程已完工
10	圣晖系统集成集团股份有限公司	4,100.00	工程施工	/	45%预付+35%进度+10%验收+10%保修	3,132.40	76.40	工程已完工
11	北京北方华创微电子装备有限公司	4,293.00	SIC外延炉	8	预付30%，收到全额发票日到货后3个月付30%，验收合格后6个月付40%	3,858.00	90.00	设备已全部交付
12	中国一冶集团有限公司	6,763.54	工程施工	/	根据工程完工进度支付	5,749.01	85.00	工程已完工
13	中国一冶集团有限公司	7,643.31	工程施工	/	根据工程完工进度支付	7,464.51	97.63	工程已完工
14	中国电子系统技术有限公司	14,033.63	工程施工	/	根据工程完工进度支付	12,979.02	92.62	工程已完工
15	中国电子系统技术有限公司	6,875.54	工程施工	/	根据工程完工进度支付	6,875.54	100.00	工程已完工
16	TOKYO ELECTRON LIMITED（东京电子株式会社）	3,593.60	ACT8425J投机	5	50%预付款，50%LC（40%发货后支付，10%不超过发货后90天）。	3,593.60	100.00	设备已全部交付

2）2024年

单位：万元

序号	供应商名称	采购合同金额	采购内容	采购数量	付款约定	已付款金额	实际付款进度（%）	截至目前资产实际交付情况
1	中国建筑股份有限公司	20,542.60	工程施工	/	根据工程完工进度支付	14,954.55	72.80	工程进度已达97%
2	Applied Materials South East Asia Pte.Ltd.（应用材料东南亚私人有限公司）	28,316.37	多腔式磁控溅射系统-正面	11	30%预付+70%LC（60%发货，10%验收）	26,214.92	92.58	设备已交付10台
3	中国电子系统技术有限公司	11,900.00	工程施工	/	20%预付+50%进度+25%验收+5%保固	8,211.00	69.00	工程已完工
4	中国电子系统技术有限公司	8,392.75	纯水主系统	/	20%预付+50%进度+20%验收+10%保固	5,119.58	61.00	工程已完工
5	KLA Corporation（科磊公司）	8,111.04	套刻精度量测	5	30%预付+70%LC（60%发货，10%验收）	8,111.04	100.00	设备已全部交付
6	KLA Corporation（科磊公司）	5,908.61	PBCVD	2	30%预付+70%LC（60%发货，10%验收）	4,210.80	71.27	设备已全部交付
7	南京晶升装备股份有限公司	3,136.00	8吋长晶炉	35	30%预付+50%发货+10%验收+10%质保	2,822.40	90.00	设备已全部交付
8	南京晶升装备股份有限公司	2,700.00	晶升420水冷机	100	合同签订后预付人民币1600万，货到且收到发票后支付人民币1000万，剩余保质期后支付。	2,600.00	96.30	设备已全部交付
9	南京晶升装备股份有限公司	4,050.00	150台长晶炉改造工程	150	合同签订后预付人民币600万，货到且收到发票后支付人民币3106万，剩余保质期后支付。	3,705.00	91.48	设备已全部交付
10	南京晶升装备股份有限公司	3,409.00	碳化硅单晶炉HSCMP570B	40	20%预付+60%到货+10%验收+10%质保	2,727.20	80.00	设备已全部交付
11	苏州市洋基机电工程有限公司	14,660.50	工程施工	/	预付款30%+进度款50%+验收款15%+保固款5%	10,709.25	73.05	工程已完工
12	LPE S.p.A.（艾尔佩股份公司）	9,530.19	MOCVD PE106外延炉	10	30%预付+70%LC（60%发货，10%验收）	6,116.22	64.18	设备已交付5台
13	LPE S.p.A.（艾尔佩股份公司）	4,676.70	MOCVD	5	30%预付+70%LC（60%发货，10%验收）	4,676.70	100.00	设备已全部交付
14	Centrotherm international AG（商先创国际股份有限公司）	6,612.13	快速退火机台	10	30%预付+70%LC（60%发货，10%验收）	5,740.61	86.82	设备已交付8台
15	Axcelis Technologies, Inc.（亚舍立科技公司）	3,010.25	离子注入机	1	30%预付+70%LC（60%发货，10%验收）	3,010.25	100.00	设备已全部交付
16	Axcelis Technologies, Inc.（亚舍立科技公司）	14,991.90	离子注入机	5	30%预付+70%LC（60%发货，10%验收）	8,607.21	57.41	设备已交付2台
17	TOKYO ELECTRON LIMITED（东京电子株式会社）	14,308.21	匀胶机ACT84C	16	50%预付款，50%LC（40%发货后支付，10%不超过发货后90天）	11,022.83	77.04	设备已交付13台

3）2025年

单位：万元

序号	供应商名称	采购合同金额	采购内容	采购数量	付款约定	已付款金额	实际付款进度（%）	截至目前资产实际交付情况
1	Canon INC.（佳能股份有限公司）	4,570.81	佳能3000系列光刻机	1	货物装运后信用证付100%	4,570.81	100.00	设备已全部交付
2	Canon INC.（佳能股份有限公司）	2,474.03	佳能3000系列光刻机	1	货物装运后信用证付100%	2,474.03	100.00	设备已全部交付
3	Canon INC.（佳能股份有限公司）	2,165.25	佳能3000系列光刻机	1	货物装运后信用证付100%	2,165.25	100.00	设备已全部交付
4	中国电子系统技术有限公司	4,800.00	工程施工	/	20%预付+50%进度+25%验收+5%保固	3,312.00	69.00	工程已完工
5	中国电子系统技术有限公司	8,392.75	工程施工	/	20%预付+50%进度+20%验收+10%保固	5,695.11	67.50	工程已完工
6	深圳市标谱半导体股份有限公司	7,179.97	印刷机、3米平移机、IC贴片机等	590	40%预付+30%货到+30%验收	6,479.41	90.24	设备已全部交付
7	深圳市标谱半导体股份有限公司	5,857.90	散料贴片机、IC贴片机等	442	40%预付+50%货到+10%验收	5,179.97	88.43	设备已交付426台
8	南昌中微半导体设备有限公司	5,288.40	金属有机气相沉积设备MPreciomoUDX	4	预付30%+到货60%+验收10%	5,288.40	100.00	设备已全部交付
9	南昌中微半导体设备有限公司	7,186.80	金属有机气相沉积设备MPreciomoUDX	6	预付30%+到货60%+验收10%	3,115.94	43.36	设备已交付4台
10	ASM International N.V.（先进半导体材料国际公共有限责任公司）	6,052.92	碳化硅外延炉MPE2C08	4	100%信用证，货物装运后支付90%，验收后支付10%。	4,006.58	66.18	设备已全部交付
11	TOKYO ELECTRON LIMITED（东京电子株式会社）	14,308.21	匀胶机ACT8#C	16	50%预付款，50%LC（40%发货后支付，10%不超过发货后90天）。	12,088.22	84.48	设备已交付13台
12	南京晶升装备股份有限公司	5,468.79	251台长晶炉改造工程	251	30%预付+50%到货+20%验收	4,379.39	80.08	设备已完成改机201台
13	南京晶升装备股份有限公司	3,409.00	碳化硅单晶炉HSCMP570B	40	20%预付+60%到货+10%验收+10%质保	2,922.47	85.73	设备已全部交付
14	Siconnex customized solutions GmbH（西蒙耐思定制化解决方案有限责任公司）	11,136.74	Pre-clean（SC1/SC2/HF/SPM）	4	40%预付款，装货前L/C50%发货款，验收后L/C10%货款	10,803.72	97.01	设备已全部交付
15	福建省工业设备安装有限公司	9,000.00	工程施工	/	依据合同内容，工程进度审批付款	3,532.84	39.25	工程已完工
16	福建省工业设备安装有限公司	6,500.00	工程施工	/	依据合同内容，工程进度审批付款	3,536.56	54.41	工程已完工
17	福建省工业设备安装有限公司	13,000.00	工程施工	/	依据合同内容，工程进度审批付款	5,947.96	45.75	工程已完工
18	泰远电子系统工程（上海）有限公司	1,515.10	工程施工	/	预付款30%+进度款50%+验收款15%+保固款5%	1,438.35	95.00	工程已完工
19	泰远电子系统工程（上海）有限公司	910.00	工程施工	/	进度款+15%验收款	707.09	77.70	工程已完工
20	泰远电子系统工程（上海）有限公司	1,635.00	工程施工	/	预付款30%+进度款50%+验收款15%+保固款5%	1,553.25	95.00	工程已完工

综上，2023年至2025年公司固定资产、在建工程采购前十大供应商主要采购合同的资产交付情况良好，公司付款情况与合同约定相匹配，不存在重大异常情形。

2、最近三年固定资产、在建工程采购前十大供应商的基本情况，该等供应商及其关键人员与公司及关联方是否存在关联关系、股权或任职关系、其他业务或资金往来，相关付款是否存在直接或间接流向控股股东及其关联方的情形

公司名称	成立时间	注册资本	主营业务	公司股东及背景	该主体及其关键人员与公司及关联方是否存在关联关系、股权或任职关系、其他业务或资金往来	相关付款是否存在直接或间接流向控股股东及其关联方
辛耘企业股份有限公司	1979年	80,331.26万新台币	业务主要覆盖半导体（前段、后段及化合物半导体）、平面显示器（TFT-LCD）、LED、MEMS微机电及科学仪器等领域	一家成立于台湾的企业，总部位于台北市	否	否
南京晶升装备股份有限公司	2012年	13,836.60万元人民币	专注于晶体生长设备和材料制备技术的研发、生产与销售	A股上市公司，证券代码：688478证券简称：晶升股份	否	否
Axcelis Technologies, Inc.（亚舍立科技公司）	1996年	/	核心产品为离子注入机及干法去胶/剥离系统	总部位于美国马萨诸塞州，纳斯达克股票代码：ACLS，是全球领先的半导体离子注入设备制造商	否	否
SPTS Technologies Ltd.（思慕斯技术有限公司）	2000年	/	专注于为半导体和微电子行业提供先进的晶圆加工技术和解决方案	总部位于英国威尔士纽波特，现为KLA旗下子公司，专注于蚀刻、离子注入、PECVD（PVD、MVD、PECVD）设备	否	否
圣晖系统集成集团股份有限公司	2003年	10,000万元人民币	从事系统集成服务；机电系统、暖通空调系统、无菌化系统及相关设备安装	A股上市公司圣晖集成（股票代码：603163）	否	否
北京北方华创微电子装备有限公司	2001年	114,163.70万元人民币	专注于高端半导体工艺装备及核心零部件的研发与制造	A股上市公司北方华创（股票代码：002371）全资子公司	否	否
中国一冶集团有限公司	1990年	241,772.70万元人民币	建设工程施工	央企子公司	否	否
中国电子系统技术有限公司	1983年	100,000万元人民币	建设工程施工	A股上市公司深赛达A（股票代码：000032）全资子公司	否	否
TOKYO ELECTRON LIMITED（东京电子株式会社）	1963年	/	覆盖晶圆加工的前后端设备，包括涂布/显影机、刻蚀系统、沉积系统和清洗系统等	总部位于日本，日本最大的半导体设备制造商	否	否
中国建筑股份有限公司	2007年	3,000,000万元人民币	建设工程施工	央企	否	否
Applied Materials South East Asia Pte.Ltd.（应用材料东南亚私人有限公司）	/	/	先进半导体工艺设备的制造、研发	Applied Materials, Inc.在新加坡设立的重要子公司，其母公司Applied Materials, Inc.总部位于美国加州，是全球半导体设备行业的巨头	否	否
KLA Corporation（科磊公司）	1975年	/	半导体量测与检测设备	总部位于美国加利福尼亚州，纳斯达克代码：KLAC	否	否
苏州市洋基机电工程有限公司	2004年	800万美元	建设工程施工	股东：STAR KING CORP	否	否
Centrotherm international AG（商先创国际股份有限公司）	1976年	/	为半导体、微电子、太阳能电池和碳纤维制造商提供热处理工艺技术和生产解决方案	德国上市公司（股票代码：CTNK）	否	否
Canon INC.（佳能股份有限公司）	1937年	/	以光学技术为核心，业务涵盖影像产品、办公设备、医疗设备及半导体生产设备等多个领域	总部位于日本，全球知名半导体设备制造企业	否	否
深圳市标谱半导体股份有限公司	2011年	4,050万元人民币	LED分光机、LED装带机、SMD分光机制造销售	持股6%以上股东：黄昌川、熊亚俊，何选民、鑫瑞集诚（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）	否	否
南昌中微半导体设备有限公司	2017年	2,500万元人民币	主要生产用于LED和功率器件外延片生产的MOCVD设备	A股上市公司中微公司（股票代码：688012）全资子公司	否	否
ASM International N.V.（先进半导体材料国际公共有限责任公司）	1968年	/	原子层沉积（ALD）设备、硅外延（Sipxi）设备	总部位于荷兰阿尔梅勒，全球领先的半导体前道薄膜工艺设备供应商	否	否
Siconnex Customized Solutions GmbH（西蒙耐思定制化解决方案有限责任公司）	/	/	研发和制造用于半导体晶圆等盘状物体的固定系统、处理装置及自动化传输设备	总部位于奥地利慕夫拜萨尔茨堡，专注于研发和制造用于半导体晶圆等盘状物体的固定系统、处理装置及自动化传输设备	否	否
福建省工业设备安装有限公司	1996年	50,000万元人民币	建设工程施工、特种设备安装改造修理	母公司为福建省建设投资集团有限责任公司，最终控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会	否	否
泰远电子系统工程（上海）有限公司	2010年	2,000万元人民币	建设工程施工修理	股东：丁克远、袁竹	否	否

2023年至2025年公司固定资产、在建工程采购前十大供应商主要为国际或国内知名半导体设备制造企业、大型建筑施工企业，公司与上述供应商及其关键人员不存在关联关系、股权或任职关系，不存在正常采购设备及支付建设工程款外的其他业务或资金往来，公司相关付款不存在直接或间接流向控股股东及其关联方的情形。

3、最近三年公司新增资产是否与增值税留抵税额相匹配

截至2025年末，公司主要子公司中增值税留抵税额金额较大的主要为湖南三安、重庆三安和湖北三安，该等子公司最近三年新增资产与增值税留抵税额的匹配关系情况如下：

单位：万元

项目	湖南三安			重庆三安			湖北三安		
	2023年	2024年	2025年	2023年	2024年	2025年	2023年	2024年	2025年
期初增值税留抵税额及待抵扣进项税额	4,924.23	5,142.92	12,248.88		26.81	5,467.24		2,124.87	3,272.09
减：本期转回	9,612.76	12,803.27	10,725.47		94.31	397.33	4,810.32	8,296.83	9,206.76
加：本期采购进项税额－长期资产类	22,479.17	23,279.71	9,725.56		5,566.86	2,289.50	1,788.06	5,019.18	2,762.26
加：本期采购进项税额－生产及服务类	12,445.08	13,493.30	10,202.13	27.66	325.67	568.5	4,815.92	6,756.74	6,993.41
减：进项税转出	333.36	487.52	562.17	0.85	356.79	122.77	234.28	84.5	34.09
减：留抵退税	26,091.44	16,376.28	3,412.94					3,589.01	1,969.98
减：出口退税							92.16	333.44	617.07
加：加计抵减								638.5	302.77
加：已抵销税额	1,331.99						65.65	1,039.23	1,202.77
加：应纳税额减征额								0.35	
期末增值税留抵税额及待抵扣进项税额	5,142.92	12,248.88	17,475.99	26.81	5,467.24	7,801.14	2,124.87	3,272.09	2,706.40
新增资产采购进项税额	22,479.17	23,279.71	9,725.56	0.00	5,566.86	2,289.50	1,788.06	5,019.18	2,762.26
新增资产采购进项税额/新增资产额	171,611.80	211,479.42	86,533.30	699.72	68,756.80	21,021.47	12,619.94	42,912.86	20,566.21
新增资产采购进项税额/新增资产额	13.10%	11.01%	11.24%	–	8.10%	10.87%	14.17%	11.70%	13.44%

上述可见，公司主要子公司最近三年增值税留抵税额与新增资产额整体匹配。

综上所述，2023–2025年度公司固定资产、在建工程采购前十大供应商主要为国际或国内知名半导体设备制造企业、大型建筑施工企业，公司与该等供应商及其关键人员不存在关联关系、股权或任职关系，不存在正常采购业务外的其他业务或资金往来；2023–2025年度公司固定资产、在建工程采购前十大供应商主要采购合同的资产交付情况良好，公司付款情况与合同约定相匹配，不存在重大异常情形，公司相关付款不存在直接或间接流向控股股东及其关联方的情形；公司主要子公司最近三年增值税留抵税额与新增资产额整体匹配。

（三）结合在建工程的入账、转固时点及其依据，说明重要在建工程项目长期挂账的原因，工程建设周期、设备安装调试周期等是否与同行业公司存在较大差异，是否存在延迟转固的情形，尚未完工项目预计未来转入固定资产的时间及条件

1、公司在建工程的入账、转固时点及其依据

公司在建工程于项目立项获批、设备及工程建设正式开工采购时开始按实际工程支出归集成本。外购设备按设备到货签收时点归集设备款；建筑工程按工程进度结算单等逐笔归集工程款、建安费、设计费、监理费、土地配套费、资本化利息等相关支出。

公司严格按照企业会计准则相关规定，在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产，其中房屋及建筑物类达到预定可使用状态时结转为固定资产，机器设备类安装调试完成并验收合格后结转为固定资产。

2、说明重要在建工程项目长期挂账的原因，是否存在延迟转固的情形

2023年至2025年，公司重要在建工程项目的投入及转固情况如下：

单位：万元

项目	2023年		2024年		2025年	
	本年投入	本年转固	本年投入	本年转固	本年投入	本年转固
泉州三安半导体科技有限公司半导体研发与产业化一期工程	11,968.08	100,471.11	12,601.57	27,770.48	4,318.59	27,489.60
泉州三安半导体科技有限公司集成电路产业化项目	18,961.27	33,962.06	26,236.25	51,095.53	9,659.90	77,410.43
湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目	12,619.04	39,833.66	42,901.79	38,999.48	19,725.26	32,895.25
湖南三安半导体有限责任公司碳化硅半导体产业化项目	171,447.67	120,099.87	206,304.96	120,716.28	79,396.47	166,192.11
重庆三安半导体碳化硅衬底项目	691.36		68,622.04	11,524.13	20,729.26	59,962.81
合计	215,688.41	294,366.69	356,666.61	250,006.90	133,828.68	363,950.20

公司重要在建工程项目采用分期建设、分批投入、分阶段转固的模式。由上表可见，2023年至2025年公司重要在建工程项目随着各期工程建设进度的推进，分批投入并结合在建工程的工程完工情况及时完成转固核算，公司重要在建工程项目不存在长期挂账或延迟转固的情形。

3、尚未完工项目预计未来转入固定资产的时间及条件

截至2025年末，公司尚未完工的重要在建工程余额以及预计未来转入固定资产的时间和条件具体如下：

项目名称	账面余额（万元）	预计未来转入固定资产的条件	预计未来转入固定资产的时间
泉州三安半导体科技有限公司半导体研发与产业化一期工程	17,975.51	mini LED及车用项目完成通线	2027年第二、三季度
泉州三安半导体科技有限公司集成电路产业化项目	26,375.89	PO1产品验证完成量产	2026年第三季度–2027年第一季度
湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目	5,804.34	TV Micro项目完成通线	2026年底
湖南三安半导体有限责任公司碳化硅半导体产业化项目	133,377.43	待化镓及重要客户认证、8吋线项目完成通线	2026年第四季度–2027年第二季度
重庆三安半导体碳化硅衬底项目	17,388.51	碳化硅扩产验证项目完成通线	2026年底

4、工程建设周期、设备安装调试周期等与同行业公司对比情况如下

公司主要项目工程建设周期与同行业可比公司对比情况详见本回复之“问题2/一/（四）/2、该项目投入规模、实施周期、效益实现情况是否与同行业可比公司类似项目存在较大差异及合理性”。

由于同行业可比公司在产品结构、设备特性、项目建设地域、产能建设规模、工艺技术路线等方面存在不同程度的差异，使得不同项目之间的工程建设周期、设备安装调试周期存在一定程度差异。公司各类项目的建设周期、设备安装调试周期均处于同行业合理区间内，不存在重大异常情形。

综上，公司在建工程入账及转固会计处理严格遵循企业会计准则相关规定，确认时点、核算依据合规充分；公司重要在建工程项目不存在长期挂账或延迟转固的情形；公司各类项目的建设周期、设备安装调试周期均处于同行业合理区间内，不存在重大异常情形。

（四）结合资产使用状态、权利受限情况、主要子公司业绩情况等，说明固定资产及在建工程减值迹象识别是否充分，2023年、2024年未计提减值的原因，2025年减值测试参数的依据及合理性，减值计提是否充分

1、结合资产使用状态、权利受限情况、主要子公司业绩情况等，说明固定资产及在建工程减值迹象识别是否充分

2025年度，公司主要子公司固定资产及在建工程资产使用状态、权利受限情况、业绩情况以及与减值迹象识别情况详见下表：

单位：亿元

子公司简称	固定资产及在建工程账面净值	资产使用状态	权利受限情况	2025年收入	2025年净利润	是否存在减值迹象	具体减值迹象
湖南三安	68.56	总体正常使用，状况良好，部分资产产能利用率相对较低	无其他权利受限	8.88	–2.45	是	部分资产产能利用率相对较低，且发生亏损
泉州集成	31.55	总体正常使用，状况良好，部分资产产能利用率相对较低	无其他权利受限	5.58	–4.01	是	部分资产产能利用率相对较低，且发生亏损
湖北三安	20.63	总体正常使用，状况良好，部分资产产能利用率相对较低	无其他权利受限	7.17	0.37	是	部分资产产能利用率相对较低
泉州三安	72.13	总体正常使用，状况良好，部分资产产能利用率相对较低	注1	40.83	–0.52	是	部分资产产能利用率相对较低，且发生亏损
泉州光通讯	2.60	总体正常使用，状况良好，部分资产产能利用率相对较低	无其他权利受限	1.54	–0.74	是	部分资产产能利用率相对较低，且发生亏损
三安集成	19.90	总体正常使用，状况良好	注2	30.76	2.81	否	–
天津三安	4.32	总体正常使用，状况良好	无其他权利受限	10.24	2.22	否	–
安徽三安	9.00	总体正常使用，状况良好	无其他权利受限	12.76	–0.37	否	–
福建晶安	5.77	总体正常使用，状况良好	无其他权利受限	6.84	0.37	否	–
芜湖安瑞	3.03	总体正常使用，状况良好	无其他权利受限	17.00	1.69	否	–
厦门三安	13.94	总体正常使用，状况良好	注2	27.47	0.01	否	–

注1：泉州三安与海外供应商豪勉科技股份有限公司因采购合同纠纷，豪勉科技股份有限公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，并申请仲裁财产保全价值人民币33,708,615.62元的财产，被实施财产保全冻结的为固定资产–房屋建筑物，该房屋建筑物年末账面原值为337,052,732.49元、账面价值为279,284,319.48元。同时公司已于2026年2月25日提起反仲裁申请。

注2：三安集成、厦门三安与芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司已签订资产售后租回协议，协议约定购买三安集成、厦门三安设备后，三安集成、厦门三安将上述设备租回，租回设备账面净值合计435,227,373.74元。

注3：子公司收入、净利润数据均摘自各子公司单体财务报表，未考虑内部交易合并抵销事项。

注4：上述固定资产及在建工程账面净值均为未计提资产减值之前的金额。

由上表可见，泉州三安、湖南三安等五家子公司固定资产及在建工程存在减值迹象，具体迹象为部分资产产能利用率相对较低或发生亏损，三安集成等其他主要子公司资产使用状况正常，收入、盈利情况良好，未发现减值迹象，因此，2025年度公司主要子公司固定资产及在建工程减值迹象识别充分。

2、2023年、2024年未计提减值的原因

公司对泉州三安、湖南三安等5家主要子公司2023年、2024年的资产减值迹象识别及减值测试结果具体如下：

单位：亿元

子公司简称	是否存在减值迹象	减值迹象识别	资产评估报告	存在减值迹象资产账面净值	可回收金额	是否减值
2023年						
湖南三安	否	收入8.51亿，净利润2.6亿，盈利能力良好，无减值迹象	–	–	–	–
泉州集成	是	部分资产产能利用率相对较低且发生亏损	中威正信评报字（2024）第1030号	11.90	12.14	可收回金额大于账面值，不减值
湖北三安	是	部分资产产能利用率相对较低	中威正信评报字（2024）第1029号	7.71	8.39	可收回金额大于账面值，不减值
泉州三安	是	部分资产产能利用率相对较低，净利润低	中威正信评报字（2024）第1032号	50.52	51.63	可收回金额大于账面值，不减值
泉州光通讯	否	新相建产线，资产使用状况良好，无减值迹象	–	–	–	–
2024年						
湖南三安	是	部分资产产能利用率相对较低，发生亏损	中威正信评报字（2025）第1026号	70.40	71.82	可收回金额大于账面值，不减值
泉州集成	是	部分资产产能利用率相对较低，发生亏损	中威正信评报字（2025）第1024号	36.34	36.98	可收回金额大于账面值，不减值
湖北三安	是	部分资产产能利用率相对较低，净利润低	中威正信评报字（2025）第1025号	22.70	24.18	可收回金额大于账面值，不减值
泉州三安	是	部分资产产能利用率相对较低，发生亏损	中威正信评报字（2025）第1022号	84.94	86.76	可收回金额大于账面值，不减值
泉州光通讯	是	部分资产产能利用率相对较低，发生亏损	中威正信评报字（2025）第1023号	3.11	3.30	可收回金额大于账面值，不减值

存在减值迹象公司2024年的营业收入及利润情况如下：

子公司简称	是否存在减值迹象	减值迹象识别
2024年		
湖南三安	是	营业收入为13.59亿，净利润–0.42亿，部分资产产能利用率相对较低，发生亏损
泉州集成	是	营业收入为5.51亿，净利润–4.02亿，部分资产产能利用率相对较低，发生亏损
湖北三安	是	营业收入为6.74亿，净利润0.89亿，部分资产产能利用率相对较低，净利润低
泉州三安	是	营业收入为36.11亿，净利润–0.05亿，部分资产产能利用率相对较低，发生亏损
泉州光通讯	是	营业收入为1.28亿，净利润–0.98亿，部分资产产能利用率相对较低，发生亏损

综上，公司2023年、2024年对湖南三安等5家主要子公司均进行资产减值迹象识别，并且对于存在减值迹象的子公司进行减值测试，同时公司聘请了中威正信（北京）资产评估有限公司进行资产评估，并出具了相应的资产评估报告。由于减值测试评估得到的可